XAFS実験

名古屋大学 シンクロトロン光研究センター 田渕雅夫

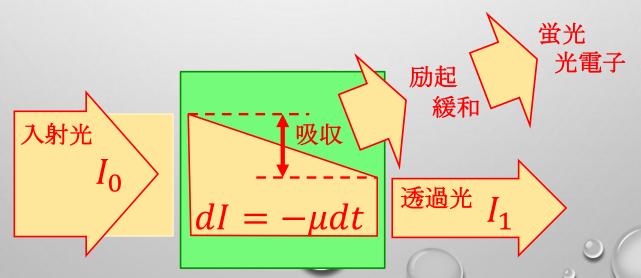
ご協力頂いた方々 スプリングエイトサービス 竹田晋吾、加藤弘泰、廣友稔樹 名古屋大学シンクロトロン光研究センター 髙濵謙太朗、塚田千恵

得たい量

- XAFS スペクトルは「X線の吸収係数: μ 」のスペクトル (ここでは μ は、線吸収係数。単位[cm^{-1}])
- 通常、試料厚さtをかけた量 μt (吸光度)として取り扱い、 μ やtを単独では扱わない(単独で考えなくて良い)。
 - 1. 試料前後の光の強度 I_0 , I_1 からすぐに求まる。 $I_1 = I_0 \exp(-\mu t)$ $\mu t = \log(\frac{I_0}{I_1})$
 - 2. 無次元量なので、例えば $\mu t = 1$ と言えば、 $\exp(-\mu t) = 0.368$ 倍(約 1/3)になることを意味する。 (但し測定値から計算した μt については注意が必要…それは後ほど)
 - 3. 規格化 $XAFS: \chi(k)$ を計算する時には、分子分母に t があるので、 t は勝手に消える。

測定する量

- ○・ *I*₀, *I*₁ が測定できるなら直接的で良い。 代わりに吸収の結果二次的に発生する 蛍光や光電子を 測定することもある。
 - 測定すべきものは、
 - 1. 入射光強度
 - 2. 透過光強度、蛍光強度、光電子電流...



今日の話の構成

光の準備	
	光源(ベンディングマグネット、ウイグラ)
	光学系(ミラー、分光器)
	スリット(視野制限、集光、分解能)

測定	透過法	蛍光法	電子収量法
特徴			
試料準備			
測定機器			
注意点			
その他			

これを真面目にやると...

今日の話の構成

 光の準備

 光源(ベンディング 4.グネット、ウイグラ)

 光学特に大事なことをチョイチョイと

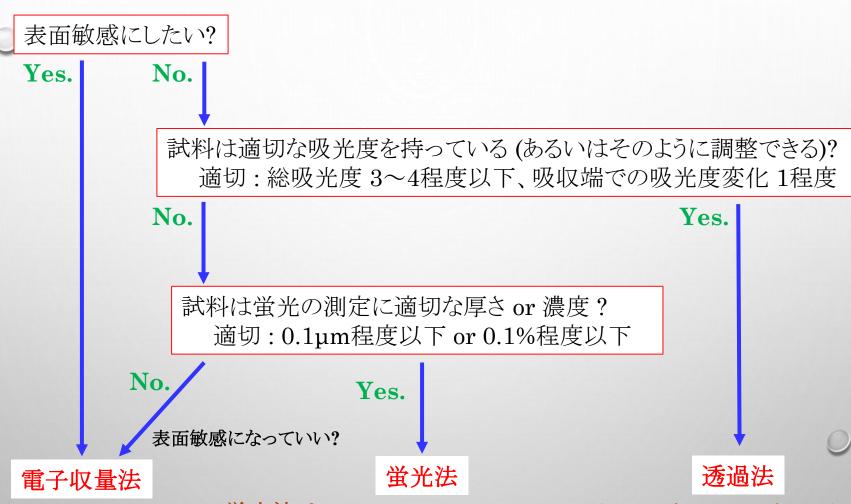
 メリット(視野制限、集光、分解能)

測定	透過法
特徴	1. さりと特徴を比較
試料準備	2. 3.
測定機器	まずこれ / 2. と違うことだけ
注意点	
その他	

測定法

- 透過法:透過光強度
 - 1. 基本の測定
 - 2. 光が透過しないといけない
 - 3. 適切な吸収量になる様に試料調整が必要
- 蛍光法: 蛍光強度
 - 1. 光が透過しない場合、または、対象元素濃度/量が小さく透過法ではシグナルが弱い場合
 - 2. 正しいXAFSスペクトルが得られる条件がある (0.1µm程度以下の薄さ or 0.1%程度以下の希薄さ)
- 電子収量法:光電子/二次電子強度
 - 1. 光が透過しない場合でも OK
 - 2. 正しいXAFSスペクトルになる条件が緩い(大体なんでもOK)
 - 3. 表面敏感(数十nmオーダー)

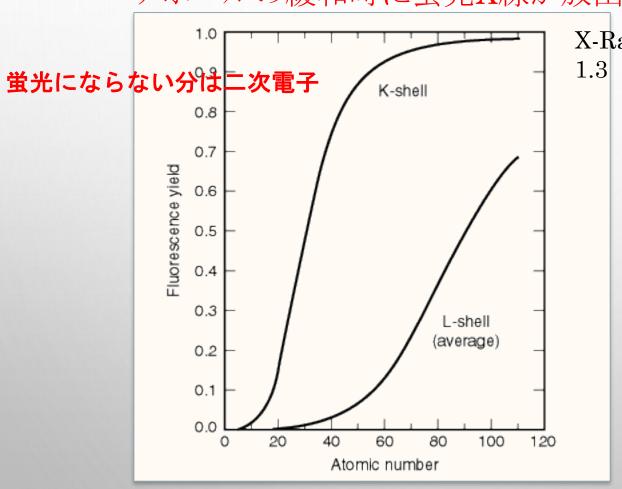
測定法の選択



蛍光法は、 共存元素の発光の重なり、回折等 他にもまだ制限要素がある 基本は透過法!を忘れずに。(ここにたどり着くよう工夫する)

蛍光法か電子収量法か一蛍光分岐比一

コアホールの緩和時に蛍光X線が放出される割合

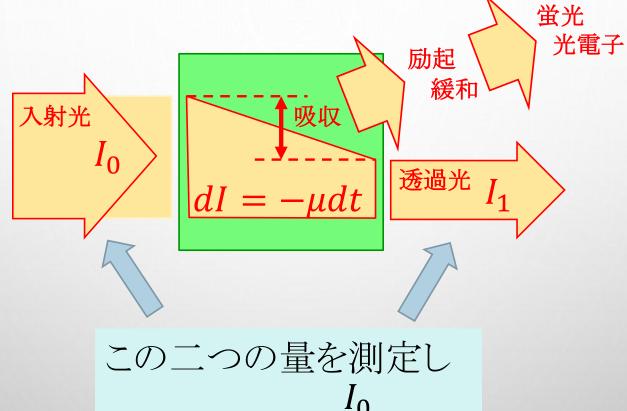


X-Ray Data Booklet, Section

原子番号 30ぐらいより軽い 原子の K端、L端全般は 本当は、電子収量の方が 効率が良い。

- 1. M. O. Krause, J. Phys. Chem. Ref. Data 8, 307 (1979).
- 2. M. O. Krause and J. H. Oliver, J. Phys. Chem. Ref. Data 8, 329 (1979).

透過法

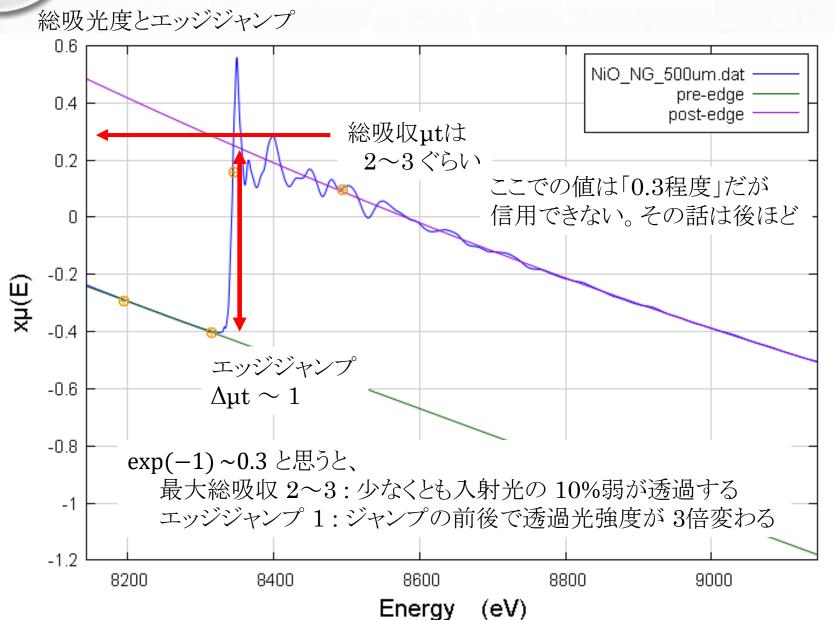


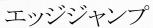
 $\mu t = \log \frac{I_0}{I_1}$ を得る。

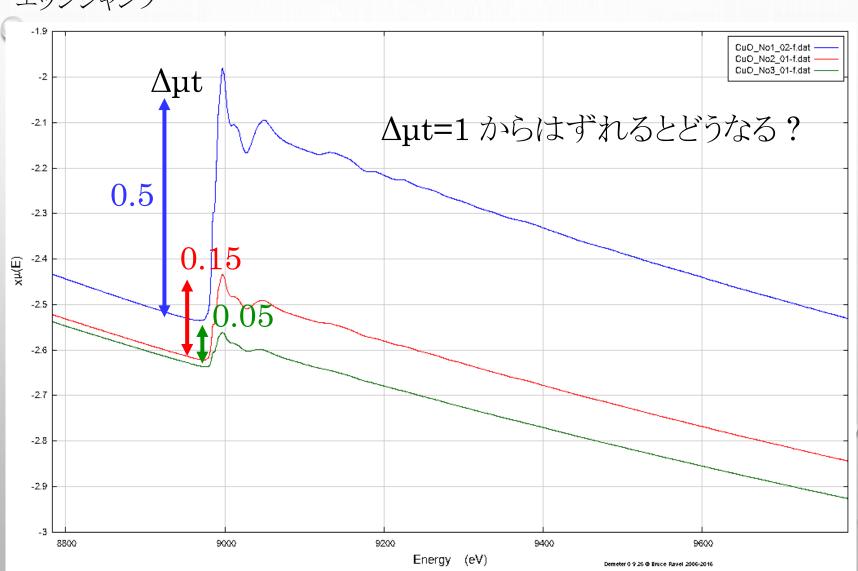
透過法のための試料準備

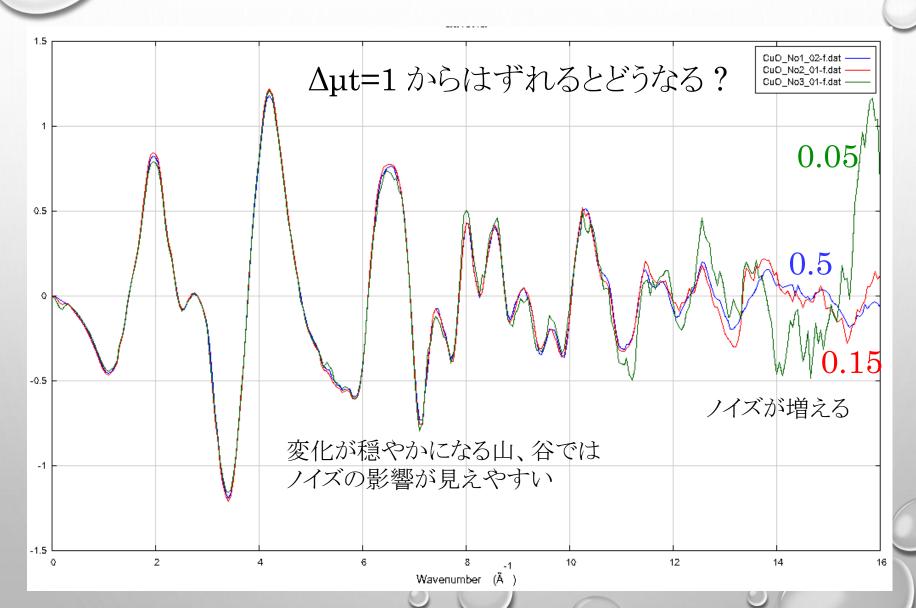
- 透過法では適切な試料の準備がとても大切 (適当な試料でも測れてしまうが、キチンと準備することの効果が大きい)
 - 1. 適切なエッジジャンプ
 - 2. 適切な総吸光度
 - 3. 十分な均質性、むら、厚さ
 - 4. 変動しない試料

透過法のための試料準備









透過法のための試料準備

- 透過法では適切な試料の準備がとても大切 (適当な試料でも測れてしまうが、キチンと準備することの効果が大きい)
 - 1. 適切なエッジジャンプ
 - 2. 適切な総吸光度

適切なエッジジャンプと適切な総吸光度の「試料を準備」する?

• 粉末状、破砕可能: 適切な量を粉砕(必要なら希釈剤と混合して) 適切な厚さ(単位面積上の試料の量)を持った ペレットにする

• 液状: 適切な厚さになるセルを準備するとか、工夫する

• X線が透過する膜状:何枚か重ねてみる

破砕できなくてX線が透過しないぐらい厚い どんなケースであれ希薄すぎる (十分なエッジジャンプにすると総吸光度が大きすぎる) 諦めて透過法以外の方法を検討する

適切な総吸収(\sim 3) と $\Delta\mu t=1$ の試料を準備するには?

Sは条件、mが決めたい量

- 1. m[g]の試料で、面積 $S[cm^2]$ のペレットを作る。結果的に厚さが t[cm] (t は具体的にわからなくてもいい)なら試料の密度は $\rho = \frac{m}{tS}[g/cm^3]$
- 2. 試料に含まれる各元素 T, A, B, C,...の原子量を N_t , N_a , N_b ,... モル比を t, a, b, c,... とする (T, t は、対象元素 : Target のつもり)
- 3. 原子量の合計 $N=\sum_{i=t,a,b,c...}iN_i=tN_T+aN_a+bN_b+...$ を計算しておく
- 4. 試料に含まれる各元素の(吸収端前後での)質量吸収係数 μ_{ρ}^{i} を得る (例えば Victoreen のテーブルの係数から計算する)
- 5. 試料中の各元素 i の密度[g/cm³]は $\rho_i = \frac{N_i}{N} \rho$ なので、各元素由来の線吸収係数は $\mu_i = \mu_\rho^i \frac{N_i}{N} \frac{m}{ts}$
- 6. 対象元素以外の吸収は、吸収端前後であまり変化しないので

$$\Delta \mu = \mu_t^{\text{Post}} - \mu_t^{\text{Pre}} \Rightarrow (\Delta \mu t) S = \frac{mN_t}{N} (\mu_\rho^{t \text{ Post}} - \mu_\rho^{t \text{ Pre}})$$

m以外の量は全部きまっているので、必要な試料の量mが決まる。

- 7. 決まったm で吸収端直後の総吸収(各元素の線吸収係数の合計)は OK? 線吸収係数($\mu_{\rho}\rho$)の合計 $\mu = \frac{m}{tS} \sum_i \mu_{\rho}^i \frac{N_i}{N} \Rightarrow \mu t = \frac{m}{S} \sum_i \mu_{\rho}^i \frac{N_i}{N}$ を計算してみる。
- 8. 良くなかったら、Δμt が多少理想から外れたとしても、総吸収を適当にできるか検討

適切な総吸収(\sim 3) と $\Delta\mu t=1$ の試料を準備するには?

Sは条件、mが決めたい量

- 1. m[g]の試料で、面積 $S[cm^2]$ のペレットを作る。結果的に厚さが t[cm] (t は具体的にわからなくてもいい)なら試料の密度は $o = \frac{m}{2}[g/cm^3]$
- こんな計算やってられない!!!! という方には... 計算してくれるプログラムがあります。
- Spring-8: https://support.spring8.or.jp/xafs.html にある「試料調整ガイドプログラム」
- 田渕版:

http://titan.nusr.nagoya-u.ac.jp/Tabuchi/BL5S1/doku.php?id=absc

http://titan.nusr.nagoya-u.ac.jp/Tabuchi/BL5S1/doku.php?id=tabuchi:absc お試し下さい。web ページの整理をした結果、アドレスが変わってしまいました。

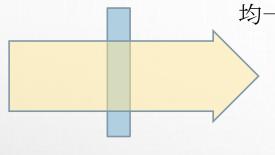
8. 良くなかったら、Δμt が多少理想から外れたとしても、総吸収を適当にできるか検討

透過法のための試料準備

- 透過法では適切な試料の準備がとても大切 (適当な試料でも測れてしまうが、キチンと準備することの効果が大きい)
 - 1. 適切なエッジジャンプ
 - 2. 適切な総吸光度
 - 3. 十分な均質性、むら、厚さ
 - 4. 変動しない試料

試料の均質性: 試料が均質でないと良好なスペクトルが得られない

均一な µt の試料が光を全部受けた場合



$$I_{1} = I_{0} \exp -\mu t$$

$$\frac{I_{1}}{I_{0}} = \exp -\mu t$$

$$\log \frac{I_{1}}{I_{0}} = -\mu t \Longrightarrow \mu t = \log \frac{I_{0}}{I_{1}}$$

厚さ2倍の試料が光の半分を受けた場合

$$I_{1} = \frac{I_{0}}{2} + \frac{I_{0}}{2} \exp{-2\mu t}$$

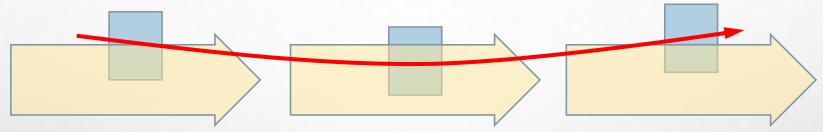
$$= \frac{I_{0}}{2} (1 + \exp{-2\mu t})$$

$$\Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{0}} = \frac{1}{2} (1 + \exp{-2\mu t})$$

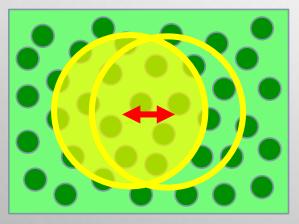
logをとってもpt に比例した量にはならない!

試料の均質性: 試料が均質でないと良好なスペクトルが得られない

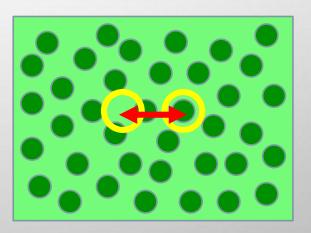
不均質さがもたらすもう一つの効果



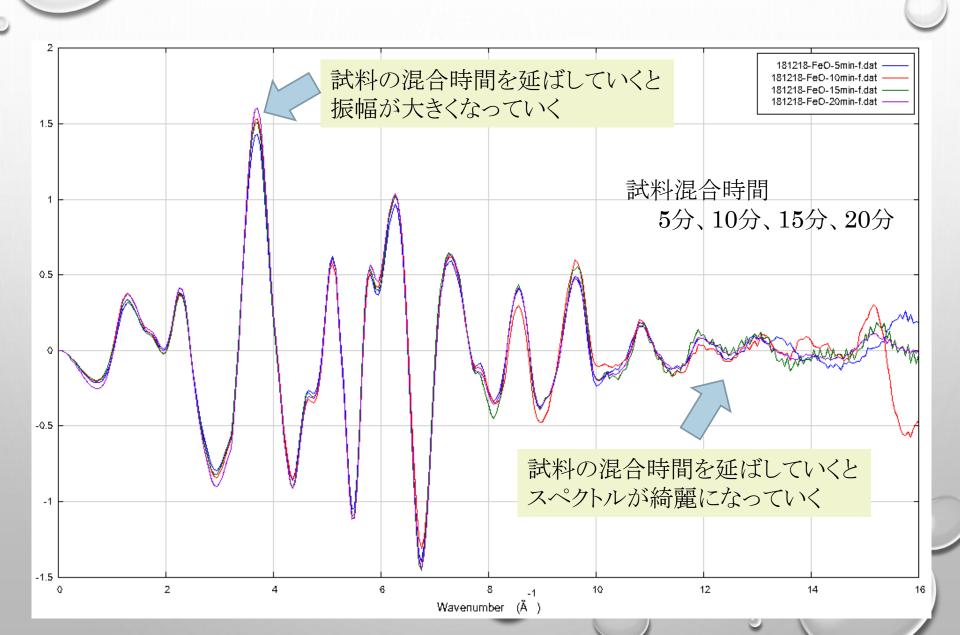
時間とともに、光or試料位置が変動すると測定結果も変動してしまう。



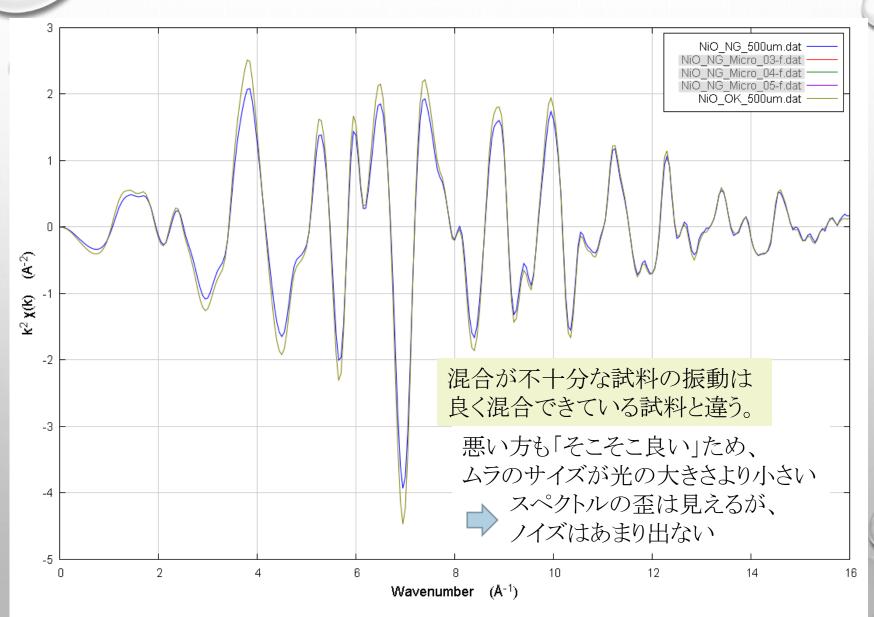
「ムラ」に対して光のサイズが大きければあまり気にならない可能性もある



昨今の光はよく集光できていて小さいので 小さなスケールのムラが気になるかも

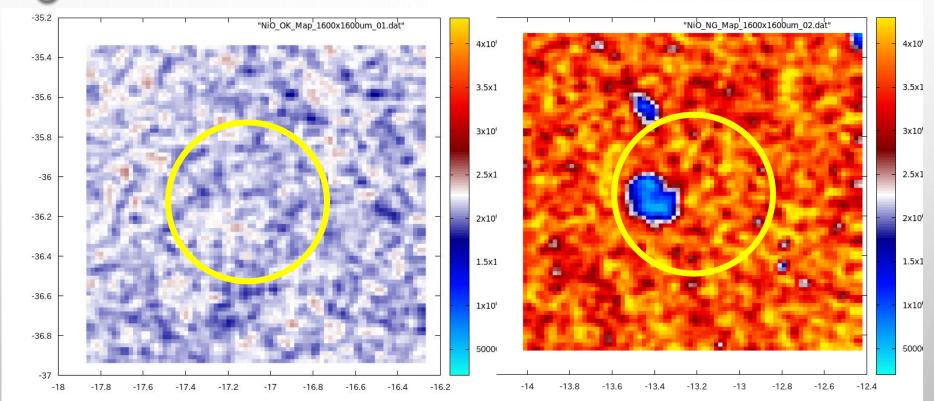


透過法のための試料準備

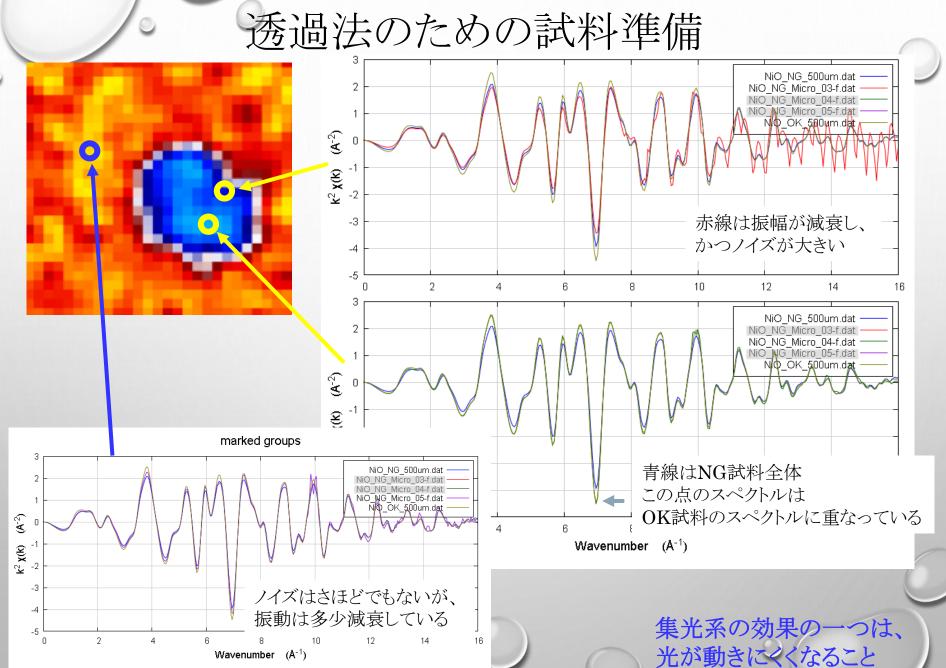


透過法のための試料準備

\bigcirc 透過光強度の2次元マップ(1.6mm x 1.6mm):ビームサイズ ~ 20 μm

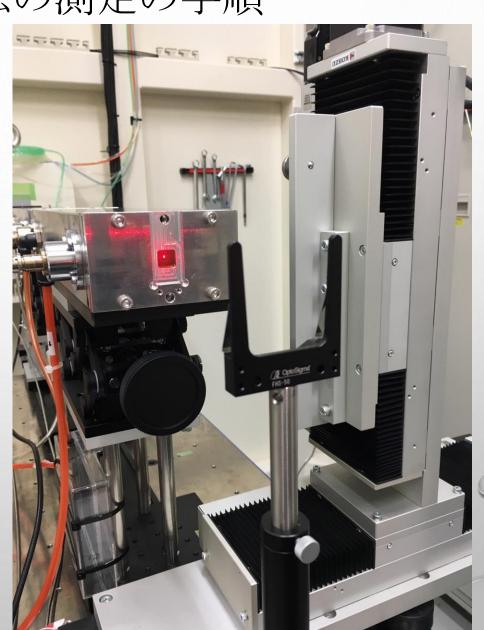


- 二つの図は同じカラースケール
- 左は1.9~2.3x10⁶ 約20%の変動、
 右は0.3~4.3x10⁶ 10倍以上変動 (青の粒子が無ければ30%程度)

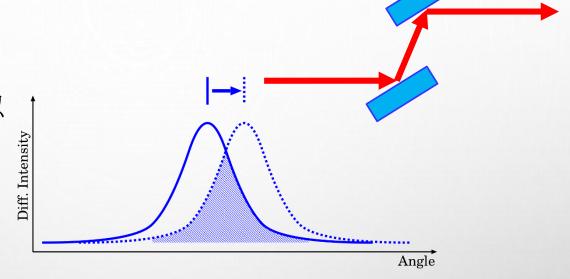


- 試料設置
 チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測器レンジ確認
- 5. 結果の判断

in-situ、特別な形態の試料等 特別なことが無い限りとても簡単



- 試料設置
 チューニ
 - チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断



- 通常、XAFS測定に使う分光器は、平行に配置した2枚の結晶でできている。この結晶 の平行度を揃えることを「チューニング」と呼ぶ。(第一結晶で選択された光と同じ波長の 光を第二結晶でも選択するようにする。)
- チューニングがずれていると、光をロスする
- (ピークの)エネルギーがずれる
- 回折角の幅 (1/1000deg 程度) 以下の非常に細かい調整が必要。 PF の場合、結晶ホルダーを押すピエゾ(圧電)素子の電圧を変えることで 無段階に微調整可能。

- 試料設置
 チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断

検出器の出力 I_0^{M} , I_1^{M} に定数成分 I_0^{0} , I_1^{0} が加わって、

$$I_0^{M} = I_0 + I_0^{0}$$

 $I_1^{M} = I_1 + I_1^{0}$

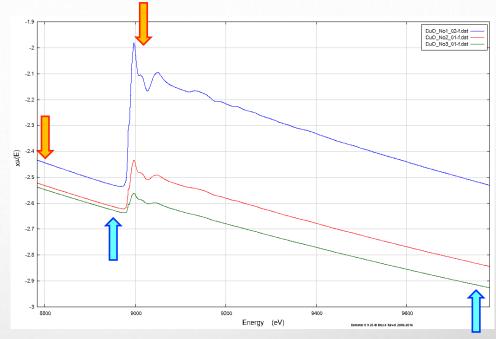
になっていると、

$$\log \frac{I_0^{M}}{I_1^{M}} = \log \frac{I_0 + I_0^{0}}{I_1 + I_1^{0}} \neq \log \frac{I_0}{I_1}$$

スペクトルが歪す。

- 実験前に計測器の暗時(光が入っていない時)の出力信号(ダーク)は必ず確認する。
- 計測器の種類やレンジを変えたときには改めて確認する。
- PFのシステムに従って暗電流測定を行えば、自動的に補正された(暗電流分を差 し引いた)データが得られるはず。

- 試料設置
 チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断



- 測定の全範囲で計測値ができるだけ「適切」な値になる様にアンプの ゲイン、光の強度等を調節する
 - 1. 計測可能な最大値を超えてしまっては全くダメ (ゲインを下げましょう)
 - 2. 例えば、最大 10.0 の信号が出せる計測器の出力が、0.1 だったら、 有効数字を 1桁失っている。(ゲインを上げましょう)
- 変化が大きくて注意が必要なのは I1
 - 1. 吸収端直後 or 最低エネルギーの点で信号最小(吸収最大)
 - 2. 吸収端直前 or 最高エネルギーの点で信号最大(吸収最小)

- 試料設置
- 試料設置
 チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断

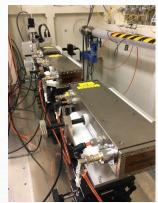
グリッチに着目すると 少しプロっぽいかも

最初は迷わず色んな人に 見てもらうのが良いと思います。

自分では大丈夫と思っていても 何か問題があることもあるかも。

- シンクロトロン(光)::また後程
- I₀, I₁の計測 イオンチャンバ





イオンチャンバたち

• 蛍光の計測:広い立体角 ライトル検出器、半導体検出器 SSD, SDD



Lytle Detector



Single SDD

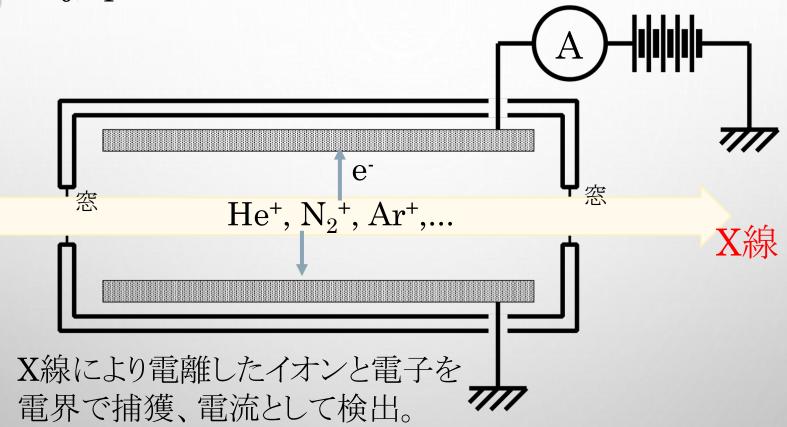


Multi SSD

・ 光電子の計測: 転換電子収量測定器



I₀, I₁の計測:イオンチャンバ



単純で信頼性が高く、質の良い信号を出力してくれるが、 「光の一部を消費する」検出器なので、充填ガスの種類(混合比)は 適切に選ぶ必要がある。

光の強度で変化する

印加雷圧

(HVの電圧)

飽和領域

測定に使う道具

• *I*₀, *I*₁ の計測:イオンチャンバ

BLの設定を信じて良い

- 1. 飽和領域で使う(数10V~数kV)
 - 多少電圧が変動しても OK
 - ガス種、長さが同じなら 見比べられる数字になる

自分で責任を持って選ぶべし

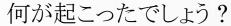
- 2. ガス種(混合比)は測定エネルギーで (吸収端によって)最適設定が違う
 - I₀:10%程度を吸収するように 大きいと試料に届く光が減る、小さいとS/Nが悪くなる
 - I₁:90%程度を吸収するように 大きすぎると窓際のみ電離され電極で電荷を捕集できない 小さいと S/N が悪くなる

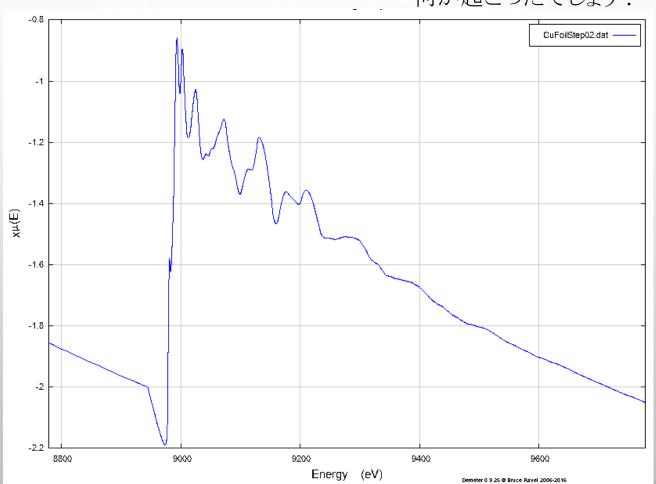
PFなら野村先生のハンドブックが参考になります。

電流

- I₀, I₁ の計測:イオンチャンバ
- 3. 取り扱いは丁寧に(特に窓)。変動に注意 XAFS測定に関連する事柄は、大体 1/1000 ぐらいの精度 の確保を目指す
 - 30cmのイオンチャンバなら、長さが 0.3mm 変動しても問題
 - 窓を触らない。傷つけたり、変形させるのは論外!
 - ガスの圧力、流量変動をなるべく避ける ガス種切り替え時は避けられない 十分落ち着いてから(パージ等終了後数分?)測定する

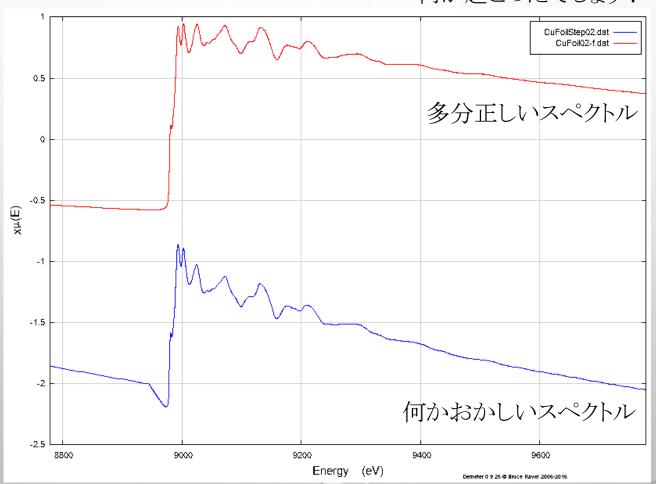
I₀, I₁の計測:イオンチャンバ





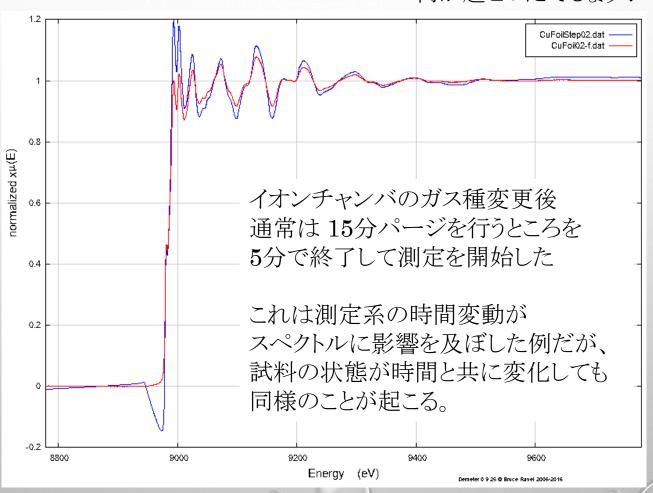
I₀, I₁の計測:イオンチャンバ

何が起こったでしょう?

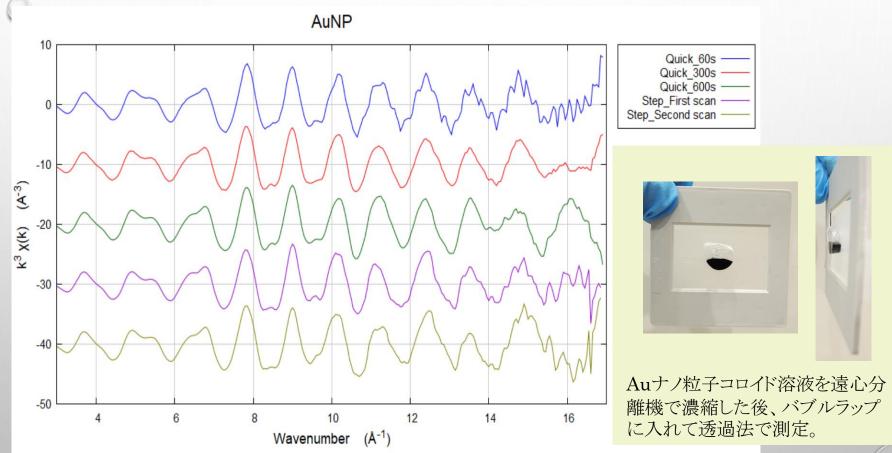


• *I*₀, *I*₁ の計測:イオンチャンバ

何が起こったでしょう?



ちょっと脱線: 試料側に経時変化がある例



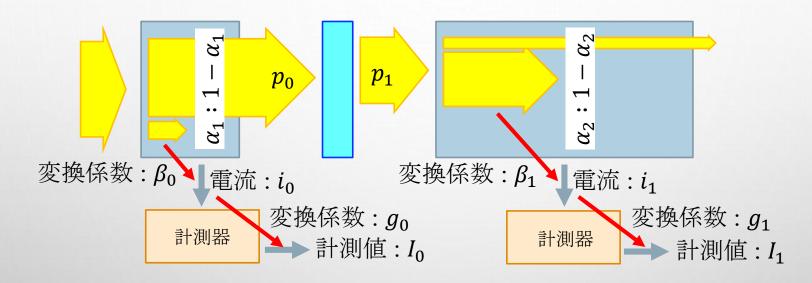
- Quick 60秒、300秒は、形状がほぼ一致しており、濃度ムラのないデータと思われる。
- その他は高波数側にガタツキが見られるので濃度ムラガ生じたと思われる。

ゲインを

測定に使う道具

4. (当たり前のことだが)

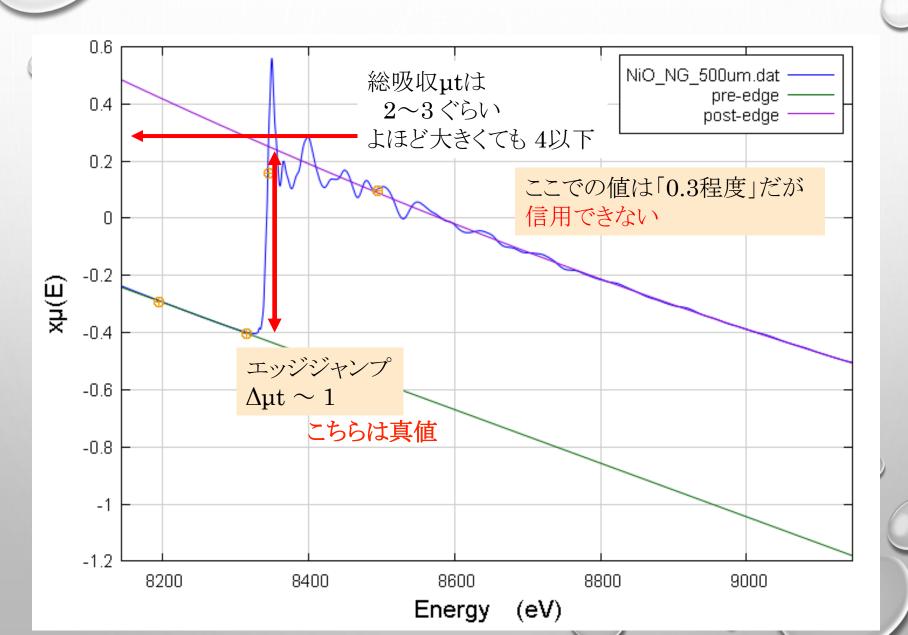
計測値は試料前後の光の強度(フォトン数)そのものではない。

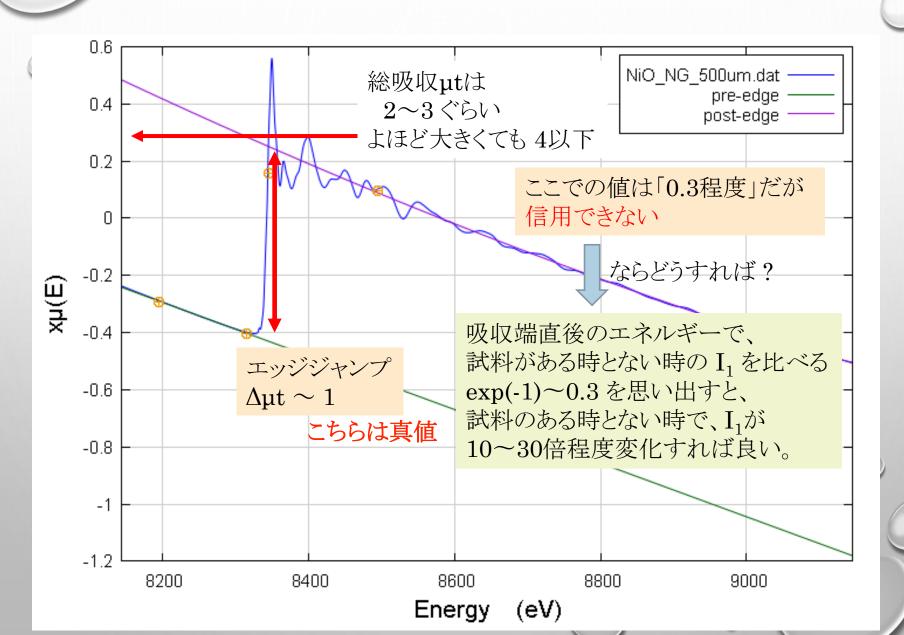


本当に μt と等しいのは $\log \frac{p_0}{p_1}$

$$\log \frac{I_0}{I_1} = \log \frac{g_0 i_0}{g_1 i_1} = \log \frac{g_0 \beta_0 \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_1} p_0}{g_1 \beta_1 \alpha_2 p_1} = \log \frac{p_0}{p_1} + \log \frac{g_0 \beta_0 \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_1}}{g_1 \beta_1 \alpha_2} = \mu t + 定数$$
 少しだけエネルギ 依存あるけど…

エッジジャンプ(Δμt)は、差し引きで「定数」が消えるので真値。



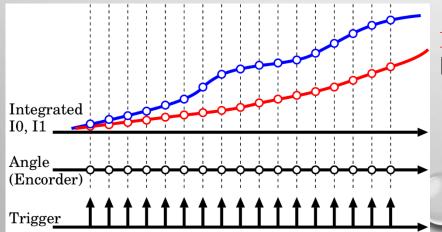


測定モード

- ステップスキャン 旧来の測定はステップスキャン。 「分光器移動」「停止」「計測」の繰り返し
- クイックスキャン 分光器を測定エネルギー範囲の始点から終点まで止めずに動かす その間計測も連続的/反復的に行う。

例えば

- 1. 分光器を測定エネルギー範囲の始点から終点まで止めずに動かす
- 2. 同時に、IO, I1 の値を積分し続ける
- 3. 適当な時間間隔でトリガパルスを発生し、 「分光器の角度(エンコーダによる計測値)」、「IO, I1の積分値 or 積分の差分値」を記録



IO, I1 の計測を止めないので、分光器が 回っている時間が全て計測の為に使える

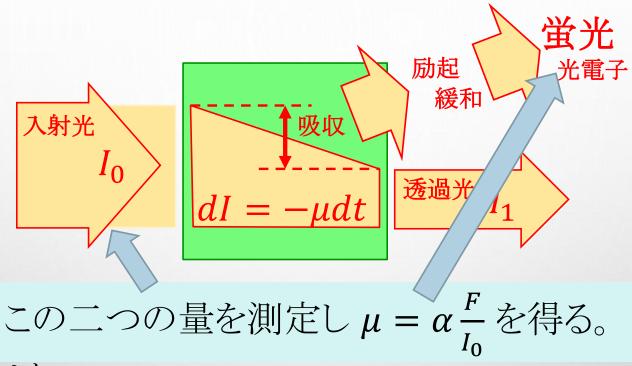
測定モード

	ステップスキャン	クイックスキャン	
効率	「計測」に使われない時間がある。「計測」時間が短いほど効率が悪い	無駄な時間がほぼない。その分、ステップより短時間の測定でもデータの質が変わらないので効率がよい	
測定時間	最短でも1点1秒程度 (全体で10分程度以上)	試料の状態さえ良ければ、全体を数秒 〜数分で測定することも可	
測定点数	吸収端前は疎に、吸収端近傍は点数を密にとり、高エネルギー側はまた疎に、等変えることで全体を数100点程度にできる	最も密にデータをとりたい吸収端近傍に併せて、全体が決まる。測定点数が数1000点になるのも普通	
選択	慣れてる、従来のデータと見比べたい、解析ソフトがクイックのデータに対応しない、クイックはなんか信用できない等何かの理由がある場合。	(XAFS測定を、一連の実験を)新しく 始める場合、クイックを選ばない理由 はあまりない。特に、短時間に多数の 試料を測定したい場合にはお勧め。 in-situ 測定等、試料の状態変化を 追いたい場合にはほぼ必須	

蛍光法ではクイックに対応しておらずステップー 択になることも。ただし、蛍光でクイックは、可能な 場合でもデータの質の問題でお勧めできない。 少なくとも、測定条件の確認にはクイックがお勧め

蛍光法

蛍光法の測定



- log ではない。
- この式は近似式近似が成立する試料でないと蛍光法で測れない
- 右辺に厚さ(t)が入る時と入らない時がある。

今回、このあたりには深入りしない(そういうものということにする)。 詳しくは、教科書等を参照して下さい。

http://titan.nusr.nagoya-u.ac.jp/Tabuchi/BL5S1の「講演資料」->「蛍光XAFS測定」も

蛍光法のための試料準備

- ・ 蛍光法では試料の準備はわりと適当で OK むしろ、そもそも蛍光法で測って良い試料かどうかが大事
- 1. 透過の測定と異なり、密度ムラ、厚さムラ等はスペクトルの 歪みの原因にならない。
 - 袋に入れた粉末
 - あるがままの試料(陶片、金属片、土壌、付着物...) でも構わない
- 2. 密度ムラ、厚さムラがあると光と試料の位置関係が動いた時にスペクトルが汚くなるのは同じ。
 - より良いスペクトルを得て、
 - → 精度の高い解析(特にEXAFS)を 行いたいなら気にするべし。

蛍光法のための試料準備

• 蛍光法では試料の準備はわりと適当で OK むしろ、そもそも蛍光法で測って良い試料かどうかが大事

$$\mu = \alpha \frac{F}{I_0}$$
と近似できる条件

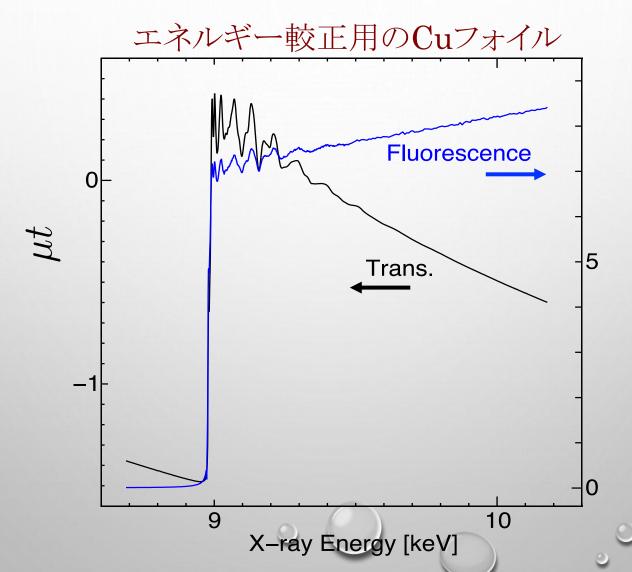
1) 十分希薄で厚い: 0.1% 程度以下が望ましい

2) 濃くて十分薄い : 0.1µm 程度以下が望ましい

- この条件を満たさないと、スペクトルが歪む。
- 振幅が小さくなるので、配位数が小さく見積もられてしまう。
- ・ 濃度が数%程度の試料をやむなく蛍光で測ることはあるが、 配位数が小さめに出るだろうことは理解しておく。
- 吸収端のシフトを議論するにはあまり問題にならない。
- ・ ホワイトラインの強度を議論するなら、同じ問題(小さめになる) があることを理解しておく

蛍光法のための試料準備

• そもそも蛍光法で測って良い試料かどうかが大事

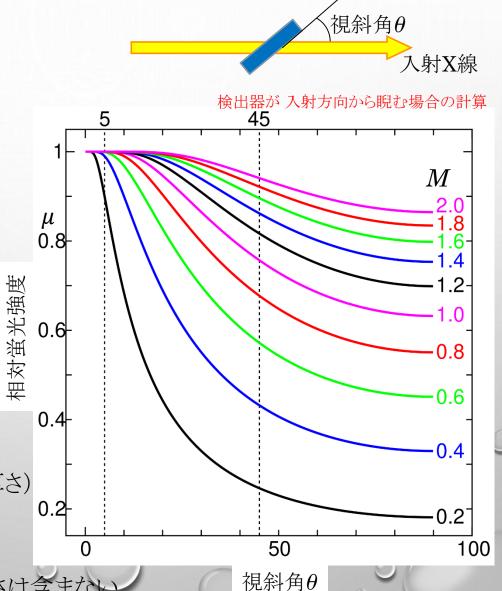


- 1. 試料設置
- 2. チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断
- 「希薄で厚い」なら試料を どう設置しても蛍光強度は ほとんど変わらない。
- 「濃くて薄膜」なら、角度は 小さい方がいい。(但し、光が漏れない範囲で)

$M = (\mu_{\rm E} + \mu_{\rm F})t$

t : 試料厚さ(対象元素を含む層の厚さ)

μ_E: 入射X線の総吸収 μ_E: 蛍光X線の総吸収



基板上の薄膜等の場合、基板の厚さは含まない

一般には

配布資料は間違い!!

$$F = \alpha I_0 \frac{\mu_E^T}{M_0} \{1 - \exp{-M_0} \frac{t}{\sin{\theta}}\}$$

$$M_0 = \mu_E + \frac{\sin{\theta}}{\sin(\theta + \varphi)} \mu_F$$

$$M = M_0 t$$

「検出器が入射方向から睨む」場合は M_0 に角度依存性が無くなるので、「試料によって決まる最大蛍光強度」

$$\alpha I_0 \frac{\mu_{\rm E}^{\rm T}}{M_0}$$

に角度依存性が無くなるので、右図

$$1 - \exp{-M_0} \frac{t}{\sin{\theta}}$$

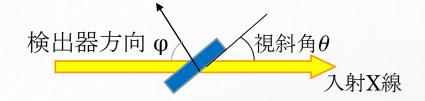
だけで蛍光強度の大小が議論できる。

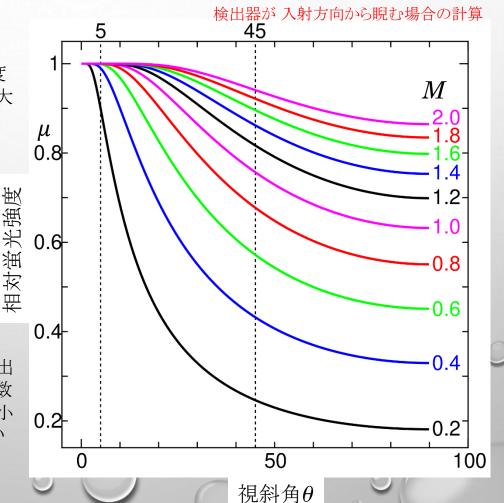
検出器が90度方向なら、

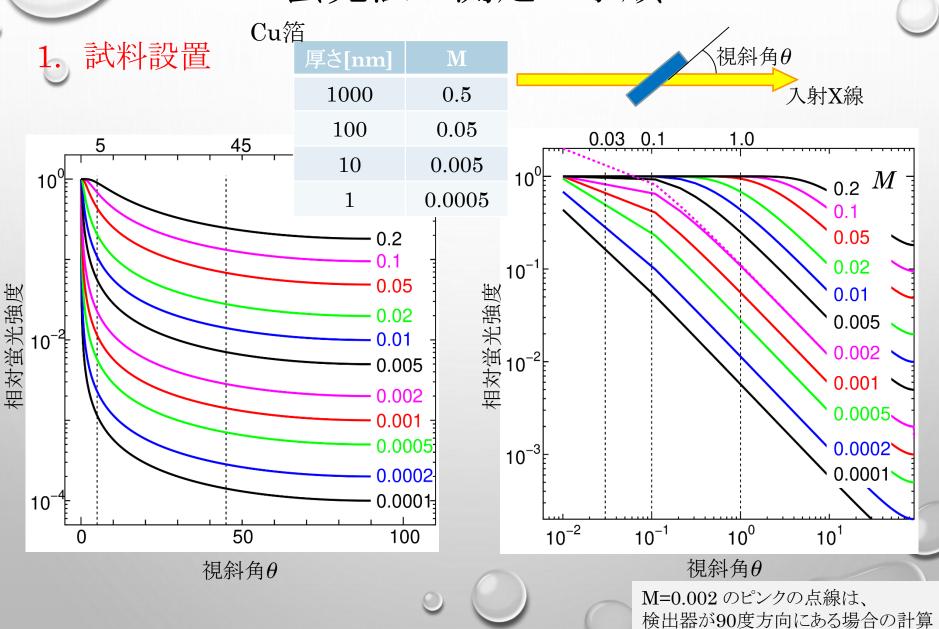
$$M_0 = \mu_{\rm E} + \tan \theta \, \mu_{\rm F}$$

になり、視射角が90度に近いとき顕著な効果が出る(expの中が大きくなる効果はほとんどなく、係数の分母が大きくなる効果が効いて、蛍光強度は小さくなる)が、普通はそんな角度にもっていかないので大体の感覚は右図で間違っていないはず。

他に、飽和強度が多少大きくなる効果もある。



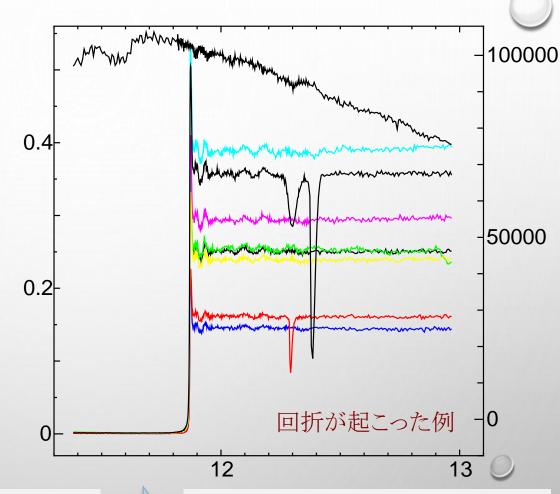




- 試料設置
- 1. 試料設直
 2. チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断
- 通常、試料をどう設置するかに あまり頓着しなくよい。
- 検出器位置は少し気を遣う (後述)
- 結晶性の試料で回折が出て しまったら置き方を変えてみる

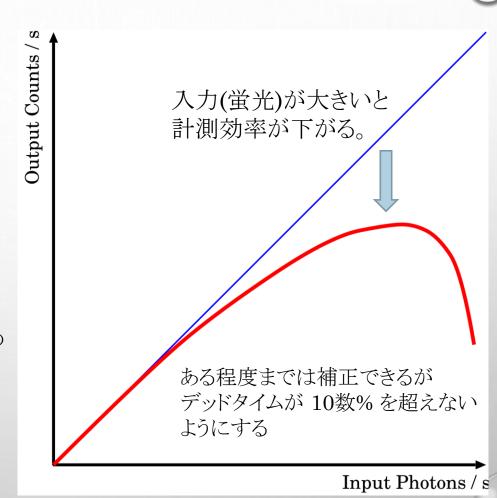
こんな症状が出たら回折かも

- •I0と無関係に、鋭いピーク状のノイズが出る
- ・一部の検出器だけに出る (時々全部に出ることも)
- ・試料や検出器の角度を変えると現れ方が変わる



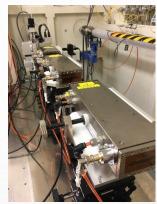
- ・配置を変えて必要な エネルギー範囲に入らないようにする
- ・回折の入った検出器は諦める
- ・試料を連続回転させる

- 試料設置
- 試料設直
 チューニング確認
- 3. ダーク確認
- 4. 計測値の範囲確認
- 5. 結果の判断
- 検出器で測定可能な強度を超えない、 信号が小さくなりすぎないようにする、 等の注意点は透過法と同じ。
- 後述する SSD/SDD等のフォトンカウント型の 検出器を使う場合には数え落とし (デッドタイム:不感時間)にも注意を払う。



- シンクロトロン(光)::また後程
- I₀, I₁の計測 イオンチャンバ





イオンチャンバたち

• 蛍光の計測:広い立体角 ライトル検出器、半導体検出器 SSD, SDD



Lytle Detector



Single SDD

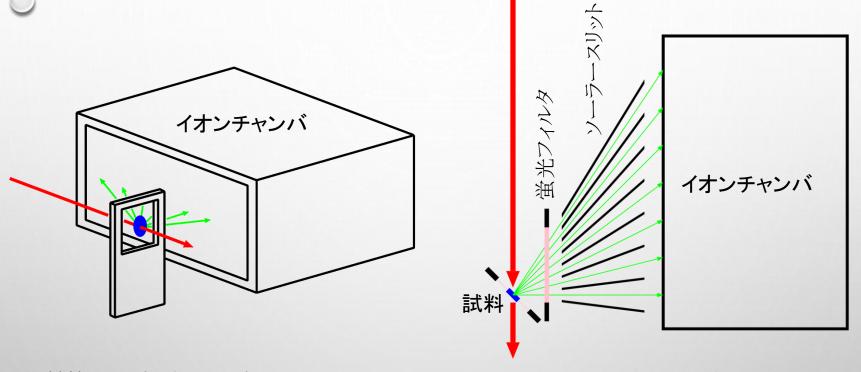


Multi SSD

・ 光電子の計測: 転換電子収量測定器

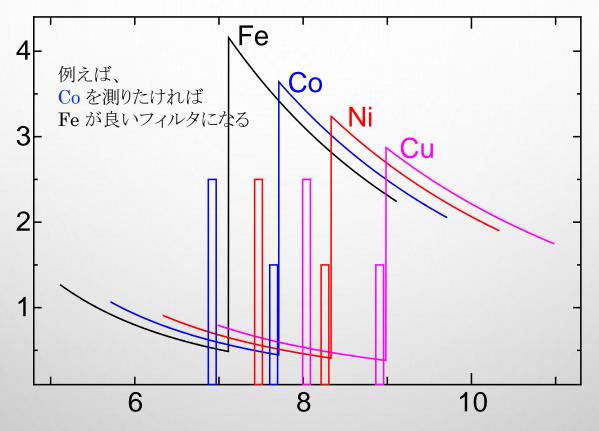


・ 蛍光の計測:ライトル検出器



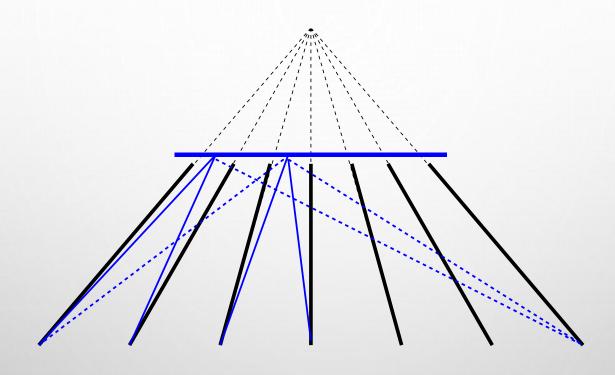
- 本質的には大受光面積のイオンチャンバ(フォトンカウントではない = 飽和しない)
- エネルギー分解能が無い、という欠点を補うため 蛍光フィルタとソーラースリットの組み合わせである程度のエネルギー選択性

蛍光フィルター(Z-1フィルター)



多くの場合、測定対象の元素(Z)よりひとつ原子番号の小さい元素(Z-1)は、測定対象の元素の蛍光X線の直後に吸収端を持つ。 高エネルギーカットフィルター/バンドパスフィルター

ソーラスリットと蛍光フィルターの組み合わせ



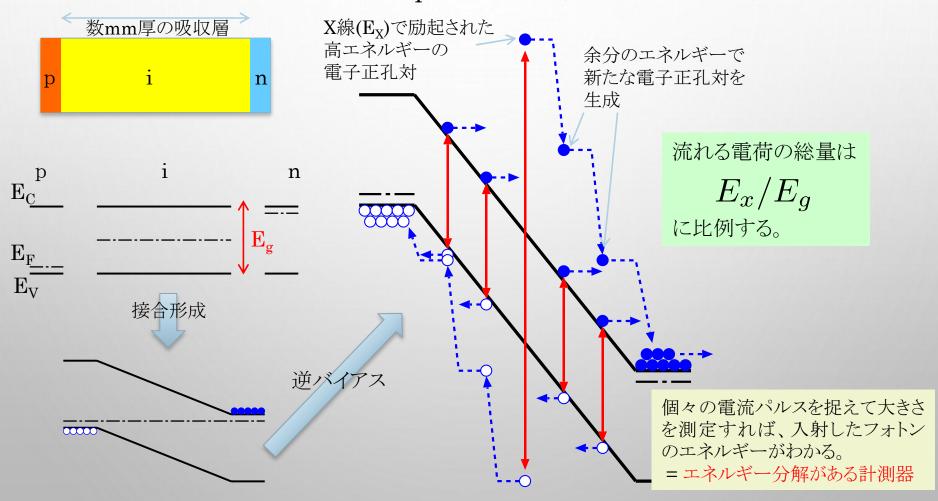
Z-1 フィルターは試料から来る高エネルギーの散乱X線を減衰させるが、自身が新たな散乱源、蛍光源になる。



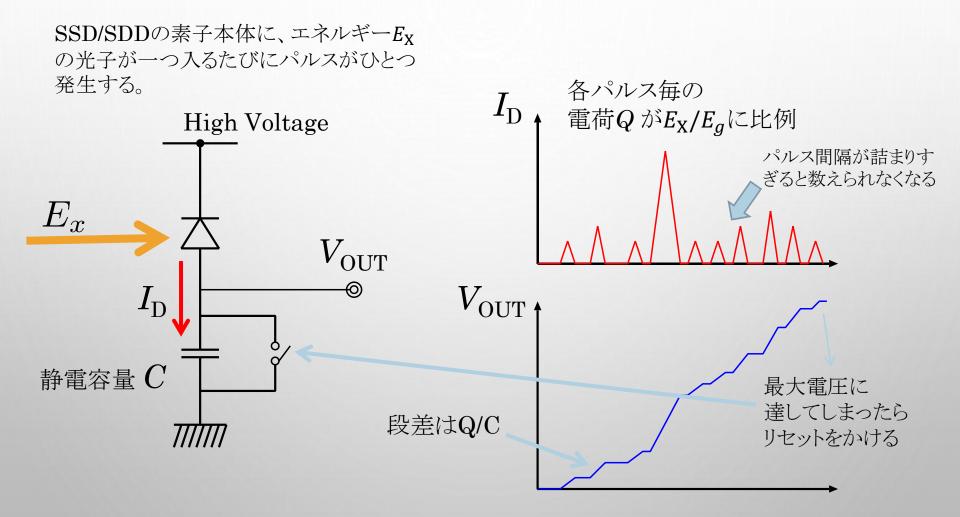
ソーラースリットと組み合わせることでより良い効果を得られる。

• 蛍光の計測:半導体検出器 SSD (solid state detector), SDD (silicon drift detector)

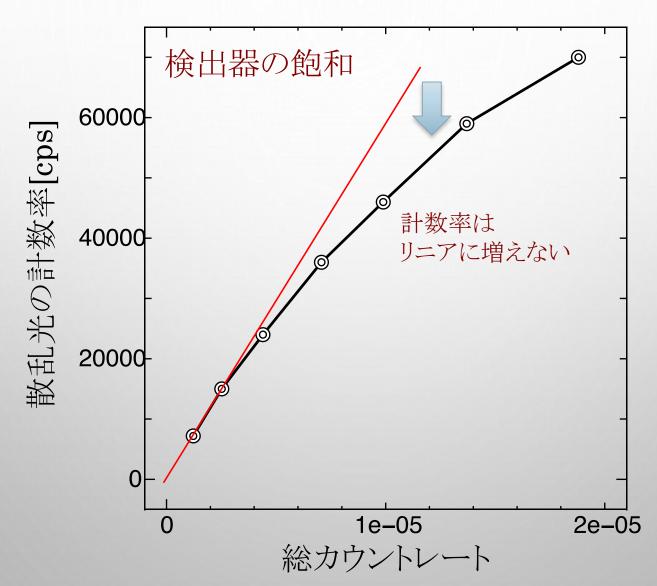
どちらも原理的には半導体pin接合素子。構造が少し違う。



• 蛍光の計測:半導体検出器 SSD, SDD



• SSD, SDDのデッドタイム、数え落とし、補正

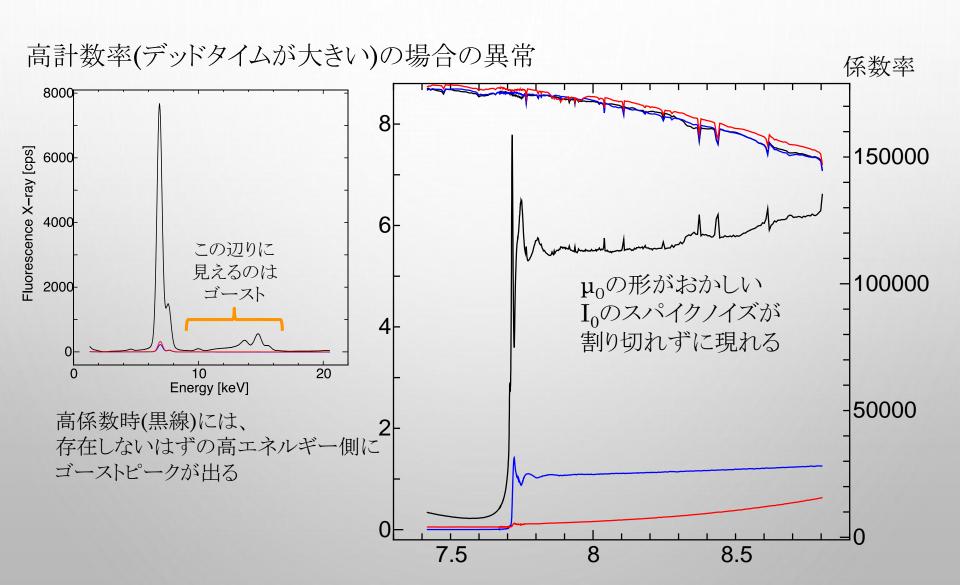


- SSD, SDDのデッドタイム、数え落とし、補正
- 1. 測定器にパルスが一つはいった時、その処理が終わるまで τ 秒間次の測定ができない。(τ は装置の設定や性能で決まる定数)
- 2. 測定器に1秒間に総数 N_0 のパルスが流れ込む。
- 3. この、 $N_0\tau$ の時間は次のパルスの計測ができなくなるので計測効率が $1-N_0\tau$ に下がる。
- 4. 計測器が処理できる総パルス数 N は $N = N_0(1 N_0\tau)$ に減る。 ひとつ前の図の様な測定をすると、あらかじめ τ を知ることができる。
- 5. 測定対象の蛍光のパルスが n_0 あるとすると、これは全体の一部だが、同じ割合で妨害を受けるので、実際に計測されるパルス数は $n=n_0(1-N_0\tau)$ に減る。
- 6. 総カウントレート N_0 と τ が分かっていれば、真の n_0 が求まる。

$$n_0 = \frac{n}{1 - N_0 \tau}$$

但し、 N_0 は、その都度求める。(通常データファイルに自動的に記録されてます)

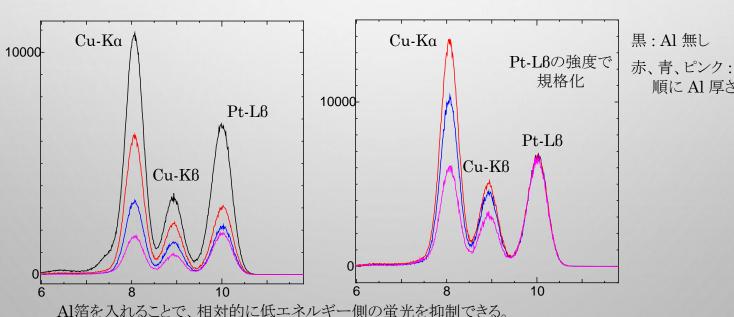
• SSD, SDDのデッドタイム、数え落とし、補正



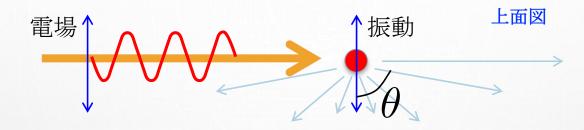
順に Al 厚さ増加

蛍光測定に使う道具

- SSD、SDDのデッドタイム、数え落とし、補正
 - 1. 補正を行うことも大事だが限界もある
 - 2. 総係数率を下げるように工夫する 目的の蛍光以外の信号強度を下げる
 - ソーラスリット、蛍光フィルターの使用
 - 低エネルギーフィルターの使用 (例えば Al 箔とか)
 - 検出器位置の工夫



• 検出器位置による弾性散乱強度の違い



- 弾性散乱: 入射X線の電場に揺さぶられた電子が新たに 放射源となって放射する光(トムソン散乱)
- 振動の周波数が同じなのでエネルギーは同じ
- 微小振動子(ダイポール)が発光源なので振動方向に垂直な面内に 最も強い光が出る
- 振動方向(入射X線の電場方向)には光が出ない
- 電場ベクトルに対する角度を θ とすると、散乱強度は $\sin^2\theta$ に比例する。



「厚くて希薄な」試料:蛍光検出器は、試料と同じ高さ、

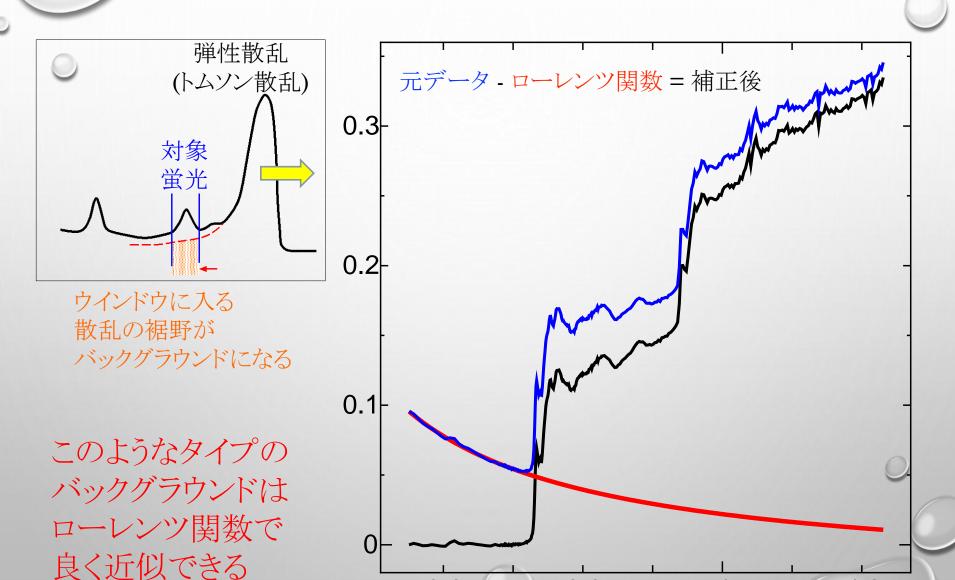
入射X線と直角の方向に置く

「薄くて濃い」試料:検出器が薄膜の面すれすれの方向に来ると

蛍光が吸収されてしまうことに注意

4.2

蛍光スペクトルのバックグラウンド



3.6

3.8

• 蛍光の計測:検出器の特徴

	ライトル	SSD	SDD
エネルギー分解能 (選択性)	無い × フィルタ使用 △	0.3keV 程度 〇	0.1~0.2keV 程度 ◎
立体角	広い〇	狭い × 多素子化 ○	狭い × 多素子化 ○
検出方式	積分型	フォトンカウント 弱信号でも高 S/N	フォトンカウント 弱信号でも高 S/N
検出速度 (強い光も OK)	ほぼ無制限	10万cps 程度 △	数十万cps 程度 ○
エネルギー範囲	高エネルギーも可 ◎	高エネルギーも可	10keV程度より上は 効率が落ちる ○
取り扱い	簡単 ◎ (ガス導入が必要)	やや面倒 $ riangle$ ($ ext{LN}_2$, $ ext{HV}$, $ ext{Be}$ 窓)	比較的簡単 ○ (HV, Be窓)
試料配置の自由度	やや低い△	高い〇	高い◎
お値段	ブランド品が 200万	1素子400万程度 19素子 数千万	1素子 200万程度 7素子 1500万

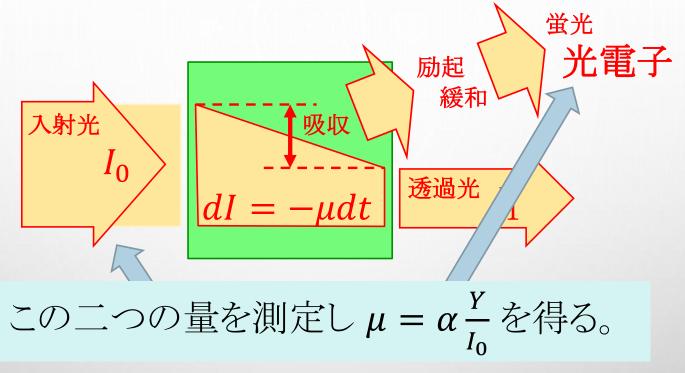
• 蛍光の計測:検出器の選択

大前提:まずは、ビームラインのお勧め、デフォルトの検出器の使用を検討しましょう。

- ライトルの出番
 - 1. エネルギー分解能が不要なとき 低エネルギー側で光る共存元素が無い or あってもエネルギーが十分離れている
 - 2. 対象元素の濃度がある程度高く、S/N が低めでも大丈夫
- SSD/SDD の出番
 - 1. 共存元素があって、蛍光X線のエネルギー選択が必要
 - 2. 対象元素の濃度が低く高い S/N が必要
 - 3. ライトルが有利な条件でも SSD/SDD で悪いわけではない
- SSD >> SDD >>?
 - 1. 普通は BL 側の選択(ユーザーは選べない)
 - 2. 選べる場合、10 keV ぐらいまでは SDD が有利、 それ以上は 20 keV ぐらいまで大差ない
 - 3. 20keV を超えるようなら SSD が有利
 - 4. SSDが有利な領域でも「手軽さ」を理由に SDD を選ぶのはあり

電子収量法

電子収量法の測定



- 測定データから μ を得る式は蛍光の場合と同じ。
- log ではない。
- この式は近似式だが蛍光の場合と異なり、ほぼいつでも成立する。(光電子の脱出深さがX線の 1/100~1/1000 のため)

測定に使う道具(試料の話より先に)

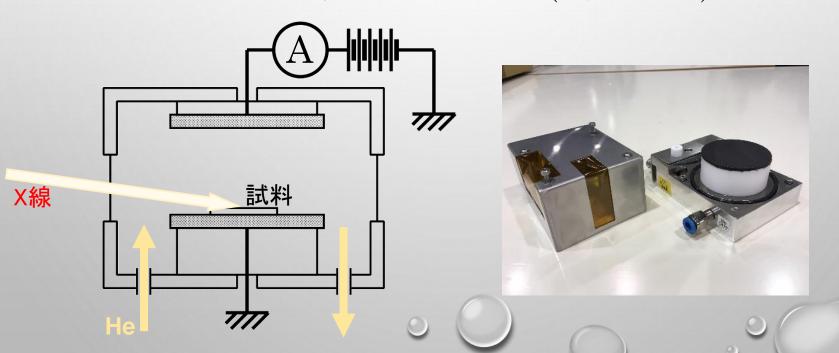
• 光電子の計測:電子収量の測定系

真空中の測定(軟X線領域の測定等)なら、電界さえかければ電子を補足できる。

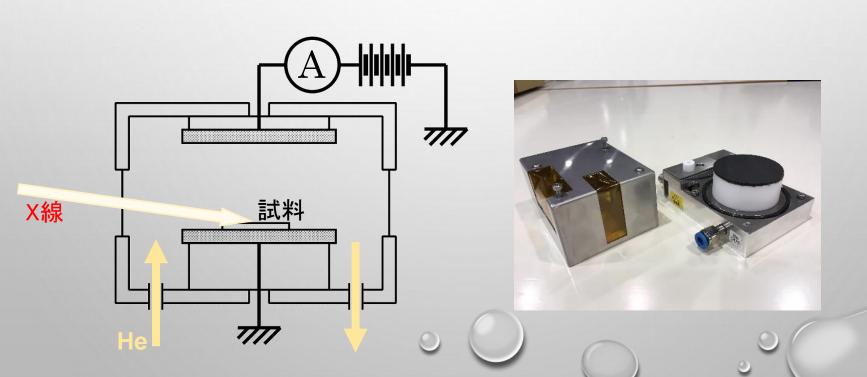
- 1. 試料に電圧をかけ、試料電流を測る(全電子収量)
- 2. 検出器を真空中に入れ、電子を検出する(部分電子収量)

大気中の測定(硬X線領域の測定等)では、光電子を補足する工夫が必要

- 1. 硬X線領域だとしても、電子収量の為に真空チャンバを用いるのは一案
- 2. He を満たした簡易チャンバを使用する (転換電子収量)



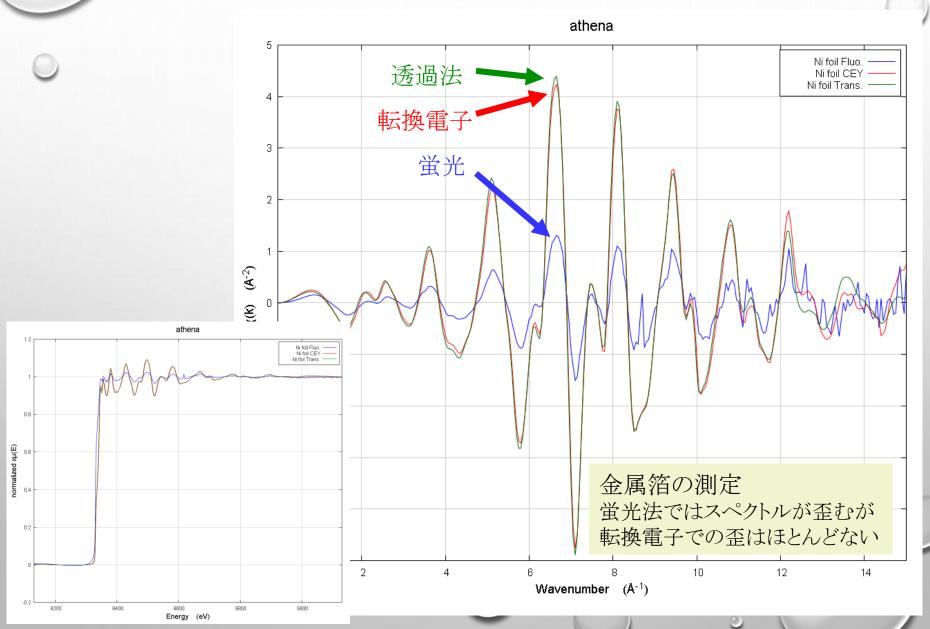
- 光電子の計測:転換電子収量(CEY, conversion electron yield)
 - 1. 光電子で気体を電離し、電子+イオンペアの電流を測定する。
 - 2. 気体は普通は He。 重い気体だと吸収係数が大きく、入射X線や試料からの蛍光X線を吸収してシ グナルが発生してしまう。
 - 3. 内部の空気の濃度が下がっていれば良いという程度のことなのでチャンバは Oリングシール等のごく簡単なもので OK (リークがあっても、内圧で吹き出す)



電子収量法のための試料準備

- 電子収量法では試料の準備はわりと適当で OK 電極表面にカーボンテープを張って、そこに粉末を振りまく 程度でも問題ない
- 絶縁性の試料でも普通は問題なく測定可能 光電子が励起した多数の荷電粒子(He+, e-)が存在する気 体雰囲気中での測定になるので、中和できる。
- 測って良い試料かどうかの制限も緩い

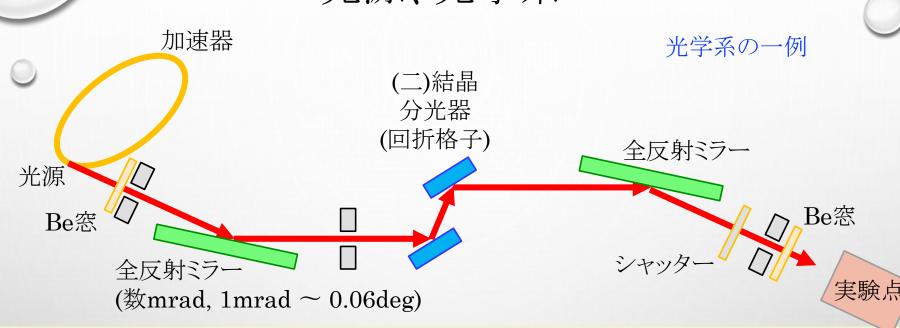
電子収量法のための試料準備



測定の手順

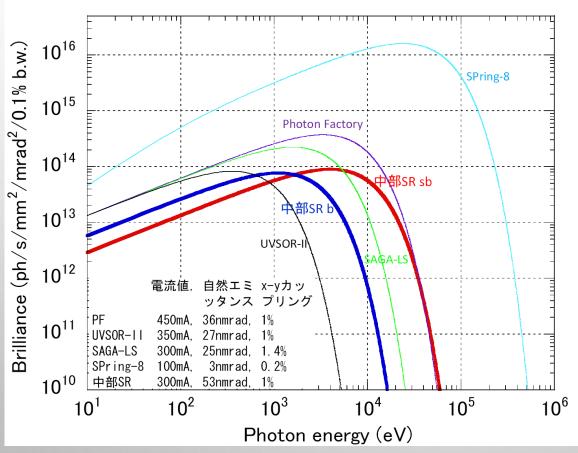
- 透過光強度を測っていたイオンチャンバの電流シグナルが、光電子/二次電子の電流シグナルに代わるだけなので、 測定回路系から見ると透過法の測定と全く同じ。
 - シグナルの強度や S/N 的にも透過法の測定に近い感覚で行える。

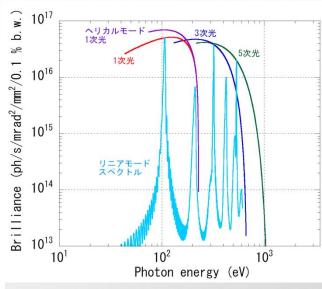
光源·光学系



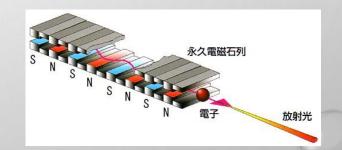
- どのように光が準備されているか、各種調整がうまくいっているかなどは ユーザーはほぼ気にしなくていい。(逆に間違えていじってしまわないように要注意)
- 光源がベンディングマグネットかアンジュレータ程度は知っておいても良いかも
- 各ビームラインの守備範囲の低エネルギー領域で実験する場合は、 「高次光」の存在と影響、光学系のミラーの働き、 分光器のチューニングを意識すべし。

加速器から出てくる光のスペクトル

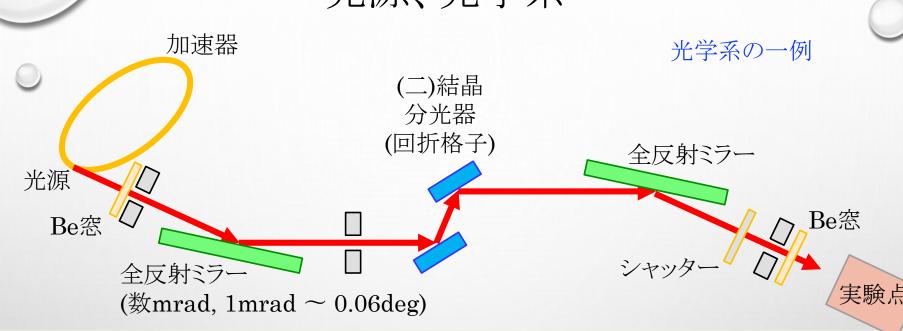




アンジュレータ

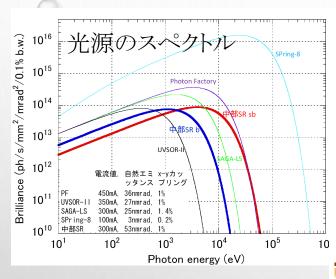


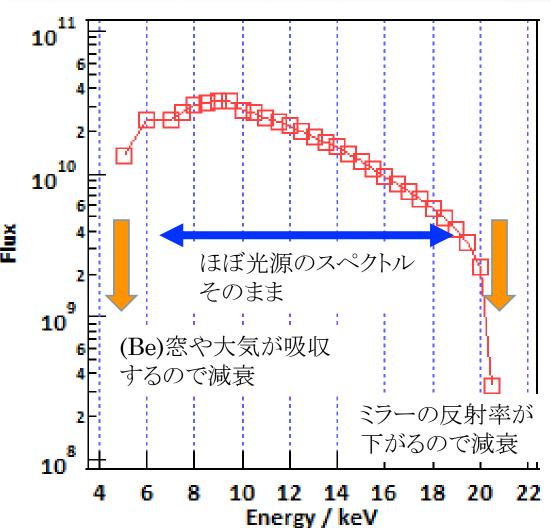
偏向電磁石

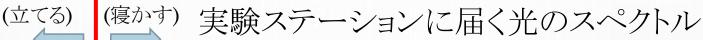


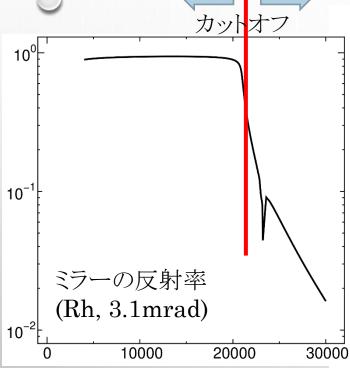
- どのように光が準備されているか、各種調整がうまくいっているかなどは ユーザーはほぼ気にしなくていい。(逆に間違えていじってしまわないように要注意)
- 光源がベンディングマグネットかアンジュレータ程度は知っておいても良いかも
- 各ビームラインの守備範囲の低エネルギー領域で実験する場合は、 「高次光」の存在と影響、光学系のミラーの働き、 分光器のチューニングを意識すべし。

試料位置に届く光のスペクトル





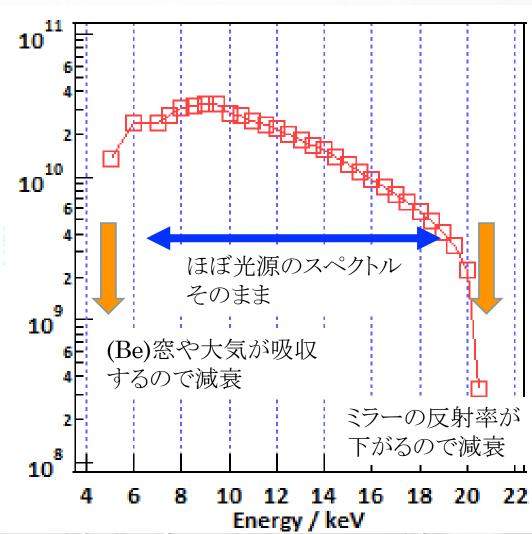




高角

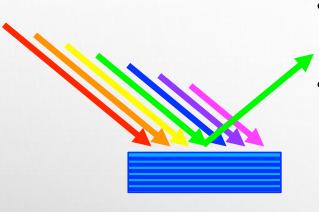
低角

- 集光や平行化の為に ミラーは必要
- カットオフを「制限」とみるか 「機能(高エネルギーカット)」 とみるか



光源、光学系 分光器と高次光

ブラッグの式 $2d\sin\theta = \lambda$ を応用して分光(波長選択)する



- 面間隔 $d=d_1$ の面があれば、 必ず面間隔 $d=d_1/n$ の面 d_n が存在する
- $2d_1\sin\theta = \lambda_1$ の時 (同じ角度 θ で)、 面 d_n によって

$$\lambda_n = 2d_n \sin\theta = 2\frac{d_1}{n}\sin\theta = \frac{\lambda_1}{n}$$
 の波も同時に回折条件を満たす。 (n倍のエネルギーを持った光:高次光が通る)

但し、回折強度は「構造因子」によって決まる。

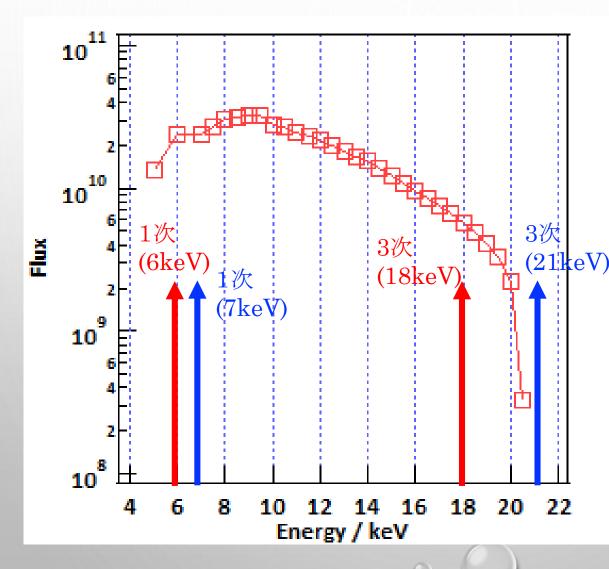
Si や Ge はダイヤモンド型の結晶構造なので、面指数を (h, k, l) とした時、 [h, k, l] が全て奇数」または「全て偶数で、[h, k, l] が全て奇数」でないと、 回折強度は [h, k, l] になる。

(111):回折する、(222):しない、(333):する、(444):する、最低次の次は3倍

(100):回折しない、(200):しない、(300):しない、(400):する、(500):しない、...

最低次の次は2倍

高次光の混入

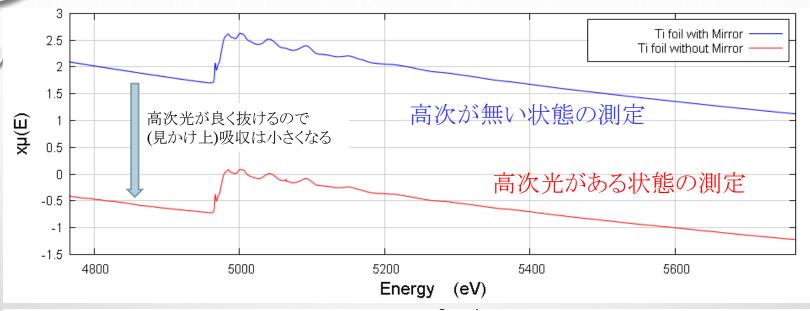


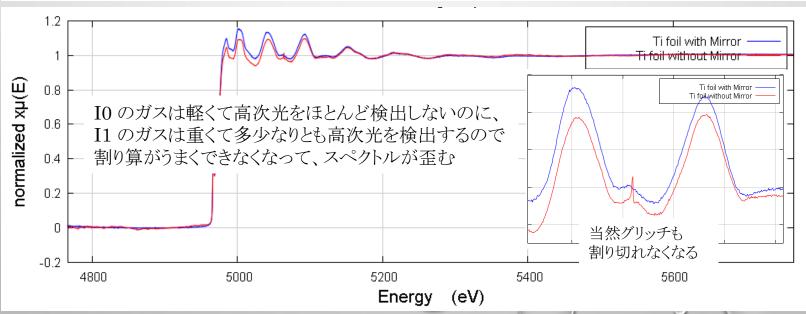
この例(ビームラインのミラーの カットオフが 20keV程度)では、 7keV程度以下の測定の時、 3次光が問題になる。

20keVより高エネルギーでの 実験が行えるビームラインでは、 (21keV)より高いエネルギーでも3次光 が問題になる。

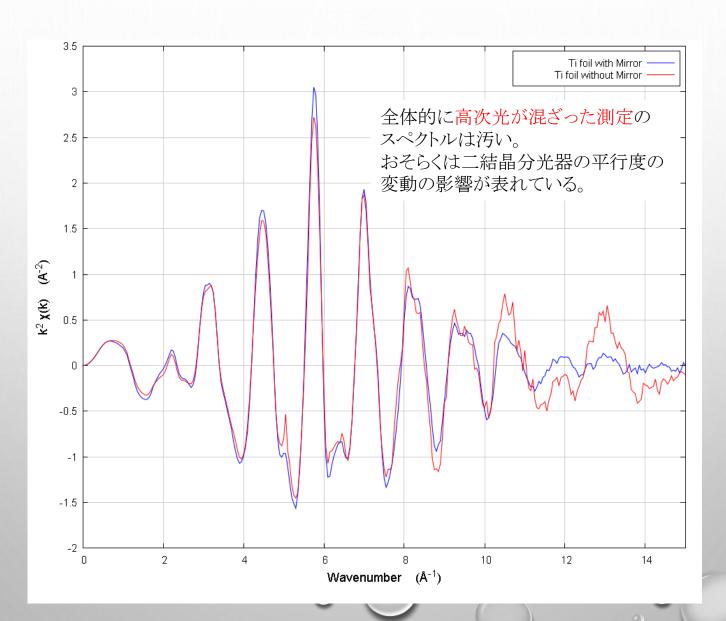
> 20keVのカットオフは、 ミラーによる「制限」であると 同時に、7keV以上の実験の時 3次光を抑制する「機能」でも ある。

高次光の影響





高次光の影響

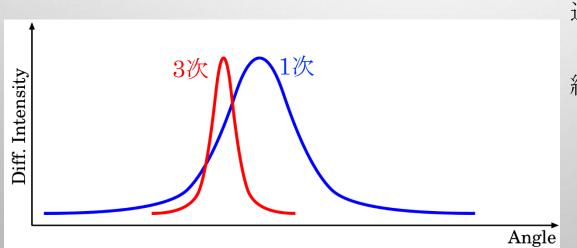


高次光を抑制する二つの方法

高次光除去ミラーの導入
 低いカットオフエネルギーを持ったミラー(ペア)を使用する。

硬X線ビームラインではBe窓や大気吸収のため4keV程度が利用可能なエネルギーの下限になる。その3倍、12keV程度以下にカットオフを持つミラーを入れると低エネルギーでも高次光を気にせず実験可能。

2. 分光器のデチューニング (1. の方法が使えるなら不要) 1次光と3次(高次)光では回折の幅が違うことを利用



逆格子空間中では同じ幅

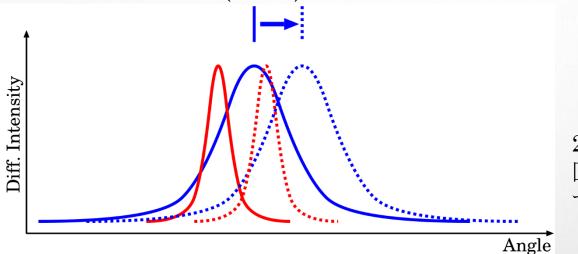
➡ 横軸角度だと 1/n の幅

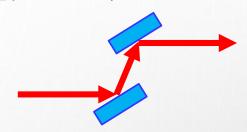
結晶中での回折角は同じ

- ⇒ 高エネルギー程屈折角が 小さい
- ⇒ 結晶外では高エネルギー の方が低角側にずれる 同じ角度には少し低い エネルギーのX線が回折

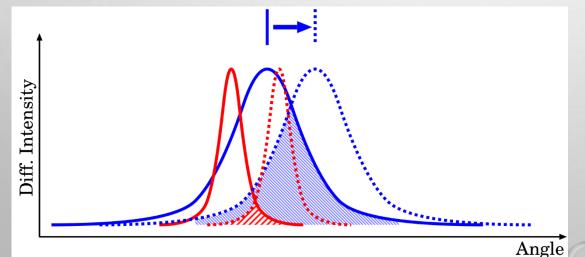
高次光を抑制する二つの方法

2. 分光器のデチューニング (1. の方法が使えるなら不要) 1次光と3次(高次)光では回折の幅が違うことを利用





2枚の結晶の角度を1次光の 回折幅のオーダー(1/1000deg)で ずらす(de-tuning)。



3次光は1次光より大きく減衰。

欠点

- 光が弱くなる
- 1/1000degのオーダで結晶の 角度がずれると、3次光の混合 割合が変わってしまう。

今日の話の構成

 光の準備

 光源(ベンディング 4.グネット、ウイグラ)

 光学特に大事なことをチョイチョイと

 メリット(視野制限、集光、分解能...)

測定	香港法 第子 大量
特徴	1. さりと特徴を比較
試料準備	2. 3.
測定機器	/ まずこれ / 2. と違うことだけ \
注意点	
その他	

End